

2021年11月9日

各 位

会 社 名 ソニーグループ株式会社  
代 表 者 名 代表執行役 吉田憲一郎  
(コード番号 6758 東証 第1部)  
問い合わせ先 財務部 IR グループ  
(TEL:03-6748-2111(代表))

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company が設立する半導体製造受託サービス子会社への  
ソニーセミコンダクタソリューションズによる少数持分出資に関する確定契約締結のお知らせ

2021年11月9日、当社の完全子会社であるソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下「SSS」)  
及び台湾積體電路製造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited、以下  
「TSMC」)は、TSMC が半導体製造受託サービスを提供する子会社を日本に設立し、SSS が当該新会社  
に少数株主として参画するための確定契約を締結したことを発表しました。本契約の定めに従い、SSS  
は、約5億米ドル(約 570 億円\*)を新会社の資本金として出資し、出資比率は 20%未満となります。な  
お、本取引の完了は、一般的なクローリング条件を満たすことが条件となります。詳細は、別添プレスリ  
リースをご参照ください。

なお、本取引による 2021 年度通期の連結業績見通しへの影響は軽微です。

\* 1米ドル=114 円として計算

以 上



SONY

2021年11月9日

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited  
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

## TSMCによる半導体ファウンドリの日本での設立と、 ソニーセミコンダクタソリューションズによる少数持分出資について

本日、TSMCとソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下「SSS」)は、TSMCが、半導体に対する世界的に旺盛な需要に対応することを目的に、22/28nmプロセスを皮切りとした半導体の製造受託サービスを提供する子会社 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 株式会社(以下「JASM」)を熊本県に設立し、SSSが、JASMに少数株主として参画することを発表しました。

JASMのファウンドリは2022年(以下暦年)の建設開始を予定しており、2024年末までに生産開始を目指します。このファウンドリは、約1,500人の先端技術に通じた人材の雇用を創出し、月間生産能力は45,000枚(300mmウェーハ)となる見込みです。このファウンドリの当初の設備投資額は約70億米ドル(約8,000億円\*)となる見込みで、日本政府から強力な支援を受ける前提で検討しています。

TSMCとSSS間で締結した確定契約に基づき、SSSは、約5億米ドル(約570億円\*)を資本金として出資することにより、20%未満の株式を取得する予定です。なお、このTSMCとSSSにおける取引の完了は、一般的なクロージング条件を満たすことが条件となります。

\* 1米ドル=114円として計算

### TSMC CEO Dr. シーシー・ウェイ

人々の生活のさらなるデジタルトランスフォーメーションにより、当社のお客様には素晴らしい機会がもたらされ、それに伴い、デジタルとリアルをつなぐ当社のスペシャルティ技術が求められています。業界を先駆けるリーダーであり、当社の長年にわたるお客様であるソニーのサポートを得て、日本で新たなファウンドリをマーケットに提供できること、そして、より多くの日本の人材を当社のグローバルファミリーに迎え入れられる機会を嬉しく思います。

### ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 社長 兼 CEO 清水 照士

世界的な半導体不足が続く中、今回のTSMCとのパートナーシップが、当社だけではなく、産業界全体のロジックウェーハの安定調達に寄与することを期待します。世界最先端の半導体生産技術を持つTSMCとのパートナーシップをより一層強め、深めていくことは、ソニーグループにとって大いに意義があるものと考えています。

このファウンドリは、TSMCが1997年に日本で子会社を設立して以来、日本の半導体エコシステムに対して貢献してきた長い歴史における新たな一歩です。直近では、TSMCは2019年に日本にデザインセンターを設立し、世界中の顧客にサービスを提供しています。また、現在、日本のパートナーと協力し、茨城県のTSMC 3DIC 研究開発センターにおいて高度なパッケージング技術の研究を進めています。



**SONY**

### 【TSMC について】

TSMC は 1987 年に設立され、お客様製品の製造を受託する、専門ファウンドリビジネスモデルの先駆者です。業界をリードするプロセス技術と設計支援ソリューションのポートフォリオにより、世界のお客様とパートナーの盛況なエコシステムをサポートし、半導体業界にイノベーションをもたらしています。アジア、ヨーロッパ、北米において事業をグローバルに展開し、世界中で企業市民としての貢献を続けています。

2020 年には、281 種のプロセス技術を展開し、最先端で特殊な高度パッケージング技術の幅広いサービスを提供することで、510 社のお客様を対象に 11,617 の製品を製造しました。また、世界で最先端の半導体プロセス技術である 5 ナノメートルの製造能力を提供する初のファウンドリで、台湾新竹サイエンスパークに本社を置きます。詳細は以下をご覧ください：<https://www.tsmc.com>

### 【ソニーセミコンダクタソリューションズについて】

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社は、ソニーグループ株式会社の 100% 子会社であり、イメージセンサーを中心に、各種 LSI、レーザー、ディスプレイデバイスを含む半導体デバイス事業を展開するイメージセンサーのリーディングカンパニーです。個人の生活に利便性や楽しみを提供するための進化したイメージング技術に加えて、新たなセンシング技術を開発・導入することで、人や機械の視覚・認識機能を究極に高める様々なソリューションの展開に取り組んでいます。詳細は以下をご覧ください：<https://www.sony-semicon.co.jp/>